

2027年3月期 第1四半期決算

(2026年4月1日～2026年6月30日)

IDEC株式会社

証券コード: 6652

2026年8月6日



IDEC株式会社 2027年3月期 第1四半期決算説明会を始めさせていただきます。

私は、本日司会を務めさせていただきます、コーポレートコミュニケーション室の元山理映子と申します。

本日の出席者をご紹介します。

代表取締役 専務執行役員 船木崇雄です。

グローバルファイナンス本部 本部長 小川泰幸です。

宜しくお願いいたします。

本日は初めに、専務の船木崇雄よりご挨拶させていただいた後、第1四半期の決算概要についてご説明させていただき、その後質疑応答を行わせていただきます。

専務、宜しくお願いいたします。

代表取締役 専務の舩木崇雄でございます。
本日はお忙しい中、弊社の決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

まず初めに、熊本地震において被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
なお、当社グループの事業活動への影響については、現時点で重大な影響は確認されておられません。

それでは、これより決算に関するご説明をさせていただきます。

中期経営計画2年目となる2027年3月期がスタートし、第1四半期は売上、利益とも前期比で大幅な増収増益となり、計画を上回る着地となりました。
グローバルでAI投資が拡大していることから、特に半導体製造装置向けの受注が前期末から大きく伸長しており、その他の業界についても需要回復が期待されている状況です。
このような受注状況も踏まえて、通期業績予想については見直しの検討を進めておりますので、とりまとめを行い、改めて公表させていただきます。

「新生IDEC」への変革を実現すべく、中計2年目となる今期は構造改革を更に加速し、顧客中心のビジネス構造を構築するとともに、One IDECを実現する取り組みを行っていきます。

第1四半期の概要は元山からご説明させていただき、皆さまのご質問には、後ほどお答えさせていただきますので、よろしくお願い致します。

01 — 2027年3月期 第1四半期の業績

第1四半期の決算のポイントについて、ご説明させていただきます。

売上

売上高 **214** 億円（前年同期比 +36.0%）

- グローバルで半導体装置向けを中心に受注が拡大している影響もあり、各地域、製品群で売上高が増加し、想定を上回る着地

利益

営業利益 **24** 億円（前年同期比 +656.4%） 利益率 **11.5** %

四半期純利益※ **47** 億円（前年同期比 +922.0%） 利益率 **22.2** %

※親会社株主に帰属する四半期純利益

- 増収の影響により、利益が大幅に伸長
- 米国旧本社の土地・建物の譲渡などにより、特別利益を約41億円計上

前期の第1四半期は、米国で新設したロジスティクスセンターの立ち上げ遅れの影響や、欧州における需要の落ち込みなどにより売上高が減少しましたが、今期はグローバルで半導体装置向けを中心に受注が拡大している影響もあり、各地域、製品群で売上高が増加し、前年同期比36%増の214億円となり、想定を上回る着地となりました。

利益についても、増収の影響により大幅に伸長し、営業利益は24億円、利益率は11.5%となりました。

また、米国旧本社の土地・建物の譲渡などにより特別利益を約41億円計上したことから、親会社株主に帰属する四半期純利益は47億円となり、利益率は22.2%でした。

連結業績



単位:百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期 1Q		2027年3月期 1Q		
	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比
売上高	15,736	100.0%	21,405	100.0%	+36.0%
売上総利益	6,643	42.2%	9,735	45.5%	+46.5%
販売費及び一般管理費	6,318	40.2%	7,277	34.0%	+15.2%
営業利益	324	2.1%	2,458	11.5%	+656.4%
経常利益	627	4.0%	2,530	11.8%	+303.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	465	3.0%	4,754	22.2%	+922.0%
1株当たり四半期純利益 (潜在株式調整前)	15.77円	—	160.69円	—	+144.92円
米ドル平均レート(円)	144.60円		159.57円		+14.97円
ユーロ平均レート(円)	163.81円		185.40円		+21.59円
人民元平均レート(円)	19.99円		23.44円		+3.45円

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

4

連結業績の全体像はご覧の通りです。

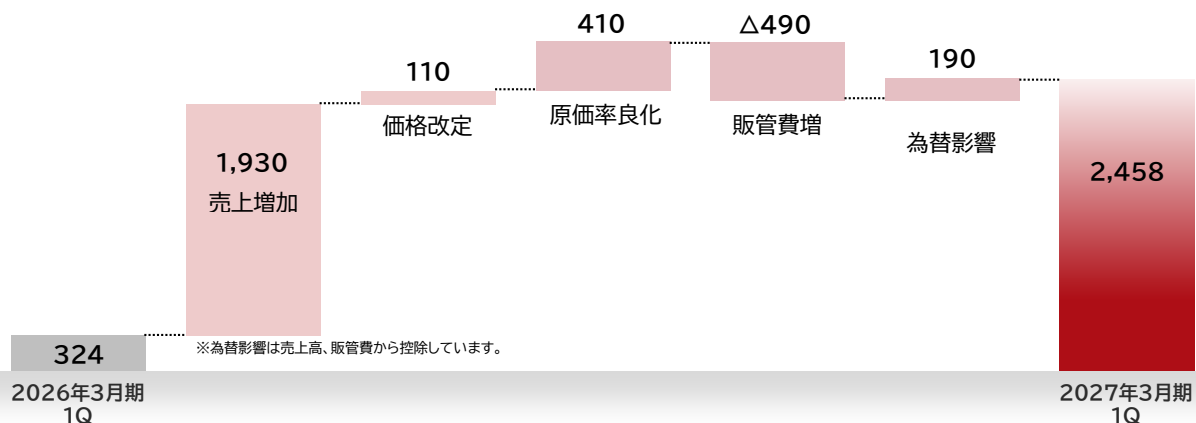
売上高の拡大に伴い、粗利率は45.5%に改善し、販管費率は34%となりました。

営業利益、経常利益ともに前年同期比で大幅な回復となり、特別利益の計上もあったことから、1株当たり四半期純利益は160.69円となりました。

営業損益変動要因



- 各地域、製品群で売上高が伸長し、価格改定効果が貢献
- 利益率の高い安全関連機器の構成比が向上したことに加え、米国の関税還付などの影響で原価率が良化
- 売上増加に伴う費用増や、インフレを背景とした労務費増により販売管理費は増加
- これらの結果、営業利益は前年同期比で約21.3億円増加



Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

5

営業利益の増減要因については、各地域、製品群において売上高が大きく伸長したことに加え、価格改定効果も貢献しました。

また、利益率の高い安全関連機器の構成比が向上したことに加え、米国の関税還付などの影響で原価率が良化しました。

一方で、販管費については、売上増加に伴う費用増や、インフレを背景とした労務費増により増加しました。

これらの結果、営業利益は前年同期比で約21.3億円の増加となりました。

連結業績(四半期)



単位:百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期								2027年3月期		
	1Q (4-6月)		2Q (7-9月)		3Q (10-12月)		4Q (1-3月)		1Q (4-6月)		
	実績	売上比	実績	売上比	実績	売上比	実績	売上比	実績	売上比	前年同期比
売上高	15,736	100.0%	18,374	100.0%	18,906	100.0%	19,950	100.0%	21,405	100.0%	+36.0%
売上総利益	6,643	42.2%	8,584	46.7%	8,377	44.3%	8,743	43.8%	9,735	45.5%	+46.5%
販売費及び一般管理費	6,318	40.2%	6,298	34.3%	6,608	35.0%	7,005	35.1%	7,277	34.0%	+15.2%
営業利益	324	2.1%	2,286	12.4%	1,769	9.4%	1,738	8.7%	2,458	11.5%	+656.4%
経常利益	627	4.0%	2,282	12.4%	2,003	10.6%	1,656	8.3%	2,530	11.8%	+303.1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	465	3.0%	1,290	7.0%	1,130	6.0%	987	4.9%	4,754	22.2%	+922.0%
1株当たり四半期純利益 (潜在株式調整前)	15.77円	-	43.71円	-	38.30円	-	33.44円	-	160.69円	-	

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

6

こちらは四半期別推移ですが、好調な受注状況を受けて、第4四半期から継続して売上高、利益ともに好調に推移し、第4四半期比でも増収増益となりました。

また、好調な業績を踏まえて業績連動の労務費を織り込んでおり、販売管理費は第4四半期比で増加しています。

仕向地別の売上状況



単位:百万円 ※百万円未満切り捨て (構成比)	2026年3月期 1Q	2027年3月期 1Q	前年同期比
日本	5,444 (34.6%)	6,749 (31.5%)	+24.0%
海外	10,291 (65.4%)	14,656 (68.5%)	+42.4%
米州	3,055 (19.4%)	4,257 (19.9%)	+39.3%
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	3,400 (21.6%)	4,657 (21.8%)	+37.0%
アジア・パシフィック	3,835 (24.4%)	5,740 (26.8%)	+49.7%
合計	15,736 (100.0%)	21,405 (100.0%)	+36.0%

日本

- 半導体やロボット業界の需要の伸長などの影響により、売上は伸長

米州

- データセンター、半導体装置向け需要の伸長により、売上は好調に推移

EMEA

- 欧州では、主要産業の需要落ち込みから徐々に回復基調に転じたことで、売上も増加傾向

アジア・パシフィック

- 中国における自動車や半導体業界などのスマートファクトリー化によるFA需要拡大により、売上は大きく伸長

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

7

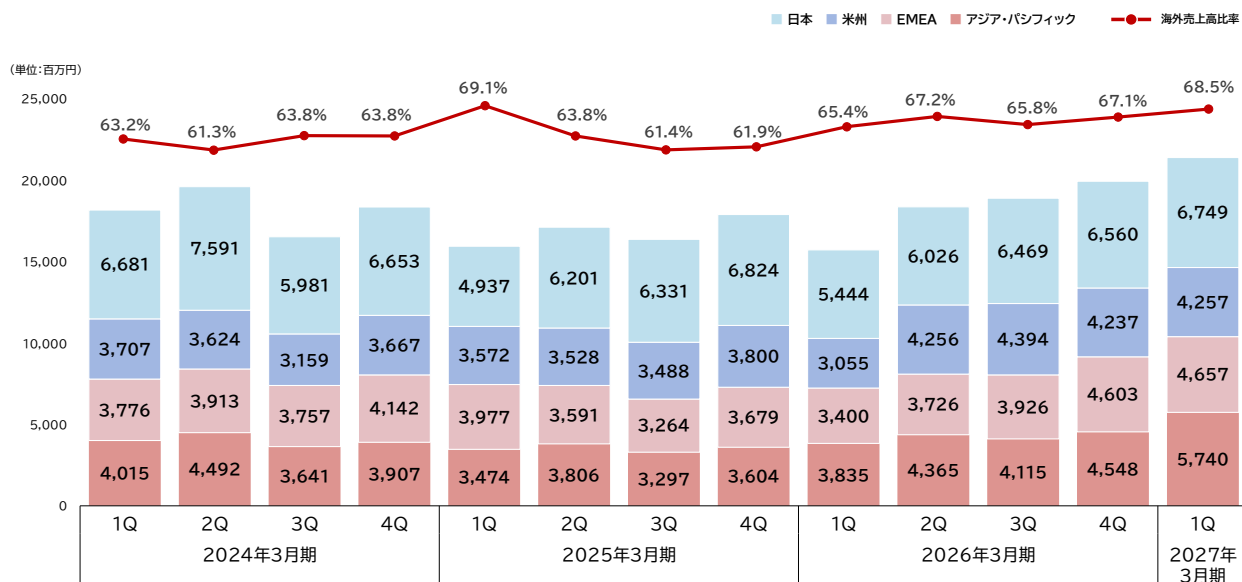
仕向け地別の売上については、前年同期比で国内外ともに大きく増加しました。

日本は、半導体やロボット業界の需要の伸長などの影響により売上は伸長し、米州も、データセンターや半導体装置向けの需要の伸長により、売上は好調に推移しました。

欧州では、主要産業の需要落ち込みから徐々に回復基調に転じたことで、売上も増加傾向となっています。

最も伸び率の大きかったアジア・パシフィックは、中国における自動車や半導体業界などのスマートファクトリー化によるファクトリーオートメーション需要の拡大により、売上が大きく伸長しました。

仕向地別の売上状況(四半期)



※百万円未満切り捨て

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

8

四半期別推移についても、各地域において第4四半期比で売
上が増加しており、特にアジアパ・シフィックを中心に海外での
伸び率が高かったことから、海外売上高比率が68.5%となり
ました。

製品別の売上状況



単位: 百万円 ※百万円未満切り捨て (構成比)	2026年3月期 1Q	2027年3月期 1Q	前年同期比		
HMI事業	7,554 (48.0%)	10,322 (48.2%)	+36.6%	HMI	FA向け、特に半導体製造装置向けの需要が牽引した結果、産業用スイッチの売上が堅調に推移
インダストリアル コンポーネンツ事業	2,905 (18.5%)	4,000 (18.7%)	+37.7%	インダストリアル コンポーネンツ	主力市場であるアジア・パシフィック、北米市場において、制御用リレーの売上が伸長
オートメーション& センシング事業	1,504 (9.6%)	2,087 (9.8%)	+38.8%	オートメーション& センシング	主力製品であるプログラマブルコントローラにおいて、主要市場である北米が堅調に推移し、OEM先への出荷も伸長
安全・防爆事業	2,742 (17.4%)	4,022 (18.8%)	+46.7%	安全・防爆	主力市場である日本、アジア・パシフィックにおいて、特に中国における安全関連機器の売上が堅調に推移
システム	1,029 (6.5%)	972 (4.5%)	△5.5%	システム	日本、アジア・パシフィックにおいて、半導体製造設備・物流関連設備等の制御盤の売上が減少
合計	15,736 (100.0%)	21,405 (100.0%)	+36.0%		

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

9

製品別の売上高については、HMI事業ではファクトリーオートメーション向け、特に半導体製造装置向けの需要が牽引した結果、主力製品である産業用スイッチの売上が堅調に推移しました。

インダストリアルコンポーネンツ事業は、主力市場である中国を中心としたアジア・パシフィック、北米市場において制御用リレーの売上が伸長しました。

オートメーション&センシング事業は、主力製品であるプログラマブルコントローラにおいて、主力市場である北米の売上が堅調に推移し、OEM先への出荷も伸長したことから、全体としても増収となりました。

安全・防爆事業は、前期に続き、主力市場である日本とアジア・パシフィック、特に中国における安全関連機器の売上が堅調に推移しました。

システムは、日本、アジア・パシフィックで、半導体製造設備、物流関連設備等の制御盤の売上が減少しました。

製品別の売上状況(四半期)



(単位:百万円)

25,000

■ HMI ■ インダストリアルコンポーネンツ ■ オートメーション&センシング ■ 安全・防爆 ■ システム ■ その他

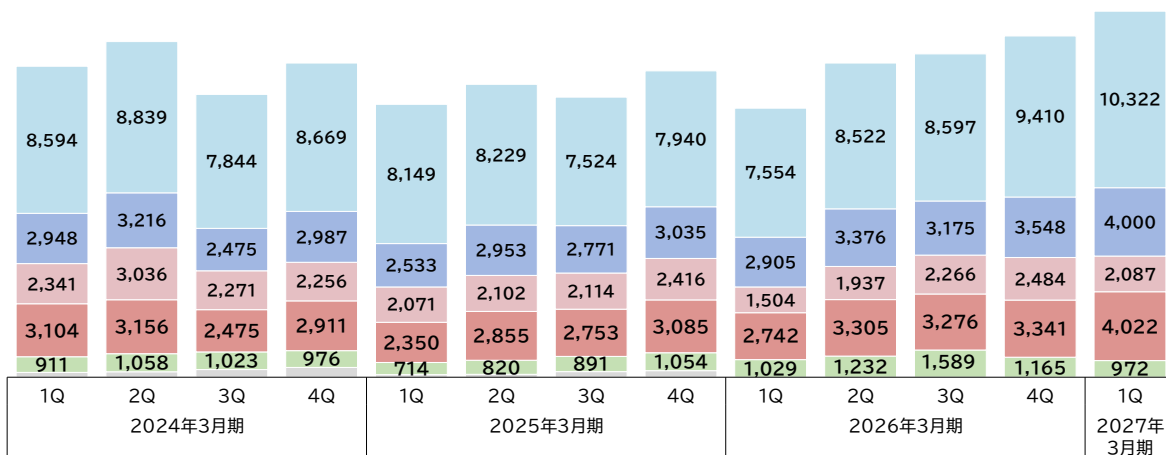
20,000

15,000

10,000

5,000

0



※百万円未満切り捨て

※ IDECシステムズ&コントロールズ株式会社(太陽光発電事業)の売却等により、2026年3月期から「その他」は廃止

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

10

四半期別推移については、第4四半期比でHMI、インダストリアルコンポーネンツ、安全・防爆事業において売上を伸ばしました。

その中でも特に、受注が好調な半導体製造装置向けに搭載される、HMIや安全関連機器に加え、中国や米国で売上比率が高いインダストリアルコンポーネンツの伸び率が高くなっています。

注力業界と傾向



- AI投資に関連して、半導体製造装置向けの投資が拡大しており、その他の各業界も需要は好調

—:横ばい ○:拡大 ◎:大きく伸長

		2027年3月期の見通し	日本	米国	欧州	中国	APAC
工作機械		・ 中国や日本を中心に、グローバルで成長が見込まれる。	○	○	○	◎	○
半導体		・ AI投資に関連して半導体製造装置向けの投資も急増し、各地域で高い成長を見込む。	◎	◎	○	◎	○
ロボット		・ 米国や中国を中心に、グローバルで一定程度の成長が見込まれる。	○	○	—	○	○
自動車		・ 中国では自動車関連投資が増加傾向。	—	—	—	○	○
特殊車両		・ 建設機械、マテハン向け装置、防衛関連の各業界とも回復傾向。	—	—	○	○	
AGV・AMR		・ 引き続き、グローバルで力強い成長が続く見込み。	○	○	○	◎	

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

11

我々が製品やソリューションを展開する注力業界はご覧の通りですが、AI投資に関連して、半導体製造装置向けの投資が各地域で拡大しており、高い成長を見込んでいます。

また、工作機械やロボット、AGV・AMRなどの業界も需要は好調で、グローバルで成長すると見込んでいます。

受注状況



- 受注高、受注残高ともに、各地域において前年同期比で大幅に増加
- 受注高は過去最高額を更新

単位:百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期 1Q		2027年3月期 1Q			
	受注高	受注残高	受注高	前年同期比	受注残高	前年同期比
日本	6,541	5,985	9,782	+49.5%	9,049	+51.2%
米州	3,557	3,191	4,997	+40.5%	4,146	+29.9%
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	2,989	7,086	5,450	+82.3%	8,524	+20.3%
アジア・パシフィック	2,421	3,269	5,390	+122.6%	5,870	+79.6%
合計	15,510	19,532	25,620	+65.2%	27,591	+41.3%

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

12

受注については、日本と中国が牽引する形で、各地域で受注高、受注残高共に大幅に増加し、受注高は過去最高額を更新しています。

受注状況(四半期)



- 日本では、前第4四半期から半導体製造装置向けの需要が受注を牽引し、第1四半期も受注が拡大
- EMEAの受注も回復しており、アジア・パシフィックは、中国で引き続き受注が好調なことから高水準で推移

単位: 百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期								2027年3月期	
	1Q (4-6月)		2Q (7-9月)		3Q (10-12月)		4Q (1-3月)		1Q (4-6月)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	受注残高
日本 (太陽光発電事業を除く)	6,541	5,985	6,875	6,168	6,621	5,627	8,282	6,605	9,782	9,049
米州	3,557	3,191	3,953	2,929	4,302	2,873	4,706	3,392	4,997	4,146
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	2,989	7,086	3,767	7,072	4,675	7,738	4,812	7,813	5,450	8,524
アジア・パシフィック	2,421	3,269	3,007	2,591	3,451	2,665	6,620	5,564	5,390	5,870
合計	15,510	19,532	17,604	18,762	19,050	18,906	24,420	23,376	25,620	27,591

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

13

四半期別の推移については、通常期末で受注高が上がる傾向にある第4四半期比でも、各地域の第1四半期の受注高は好調に推移している状況です。

特に、半導体製造装置向けの需要が受注を牽引している日本では、97億円の受注高となりました。

また、EMEAの受注も回復してきており、中国で好調な受注が続くアジア・パシフィックについても、高水準の受注が続いている状況です。

連結貸借対照表



単位:百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期 (前会計年度)	2027年3月期 (6月末)	前会計年度比 増減
流動資産	53,312	56,607	+3,295
固定資産	60,259	60,097	△162
流動負債	27,065	29,261	+2,195
固定負債	16,586	13,506	△3,080
純資産	69,920	73,938	+4,018
総資産	113,572	116,705	+3,133
自己資本比率	61.0%	63.0%	+2.0%

資産

- 現金及び預金が増加したことなどから、総資産は前期末比で約31.3億円増加

負債

- 未払法人税等や仕入債務などが増加した一方、借入金が減少したことなどから、負債は前期末比で約8.8億円減少

純資産

- 利益剰余金や為替換算調整勘定が増加したことなどから、純資産は前期末比で約40.1億円増加

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

14

貸借対照表については、現預金が増加したことなどから、総資産は前期末比で約31.3億円増加しました。

負債については、未払法人税等や仕入債務などが増加した一方、借入金が減少したことなどから、前期末比で約8.8億円減少しました。

自己資本比率は前期より2.0%増加し、63%となりました。

連結キャッシュ・フロー



単位:百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期 1Q	2027年3月期 1Q	前年同期比	
営業CF	1,795	3,428	+1,633	営業CF 売上拡大による利益増加に加え、売上債権の減少及び仕入債務の増加等により、約34.2億円
投資CF	△857	3,671	+4,529	投資CF 米国旧本社の土地・建物の譲渡、新本社への投資等により、約36.7億円
FCF ※フリーキャッシュ・フロー	937	7,100	+6,162	
財務CF	△3,072	△4,839	△1,766	財務CF 配当金の支払い及び有利子負債の返済により、約△48.3億円
現金及び現金同等物の 期末残高	16,394	20,748	+4,354	

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

15

営業キャッシュ・フローについては、売上拡大による利益増加に加え、売上債権の減少や仕入債務の増加等により、34.2億円となりました。

投資キャッシュ・フローは、米国旧本社の土地・建物の譲渡や新本社への投資等により36.7億円となり、フリーキャッシュ・フローは71億円となりました。

財務キャッシュ・フローは、配当金の支払い及び有利子負債の返済により、約△48.3億円となりました。

02 — 2027年3月 通期業績予想

なお、通期の業績予想につきましては、

2027年3月期 通期業績予想



- 外部環境を踏まえた業績予想の見直しに時間を要していることから、現時点では業績予想を据え置き
- 今後、受注動向や為替影響、投資の必要性などを踏まえ、業績への影響を慎重に見極め、確定次第、公表予定

単位:百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期		2027年3月期		
	実績	売上比	予想	売上比	前期比
売上高	72,967	100.0%	75,500	100.0%	+3.5%
売上総利益	32,349	44.3%	35,200	46.6%	+8.8%
販売費及び一般管理費	26,230	35.9%	28,000	37.1%	+6.7%
営業利益	6,118	8.4%	7,200	9.5%	+17.7%
経常利益	6,569	9.0%	6,750	8.9%	+2.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,873	5.3%	6,000	7.9%	+54.9%
1株当たり当期純利益 (潜在株式調整前)	131.22円	—	203.25円	—	+72.03円
米ドル平均レート(円)	150.67円		150.00円		△0.67円
ユーロ平均レート(円)	174.64円		180.00円		+5.36円
人民元平均レート(円)	21.22円		21.00円		△0.22円

Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

17

外部環境を踏まえた業績予想の見直しには時間を要しており、現時点では業績予想を据え置いており、変更しておりません。

今後、受注動向や為替影響、投資の必要性などを踏まえ、業績への影響を慎重に見極め、内容が確定次第、公表する予定です。

2027年3月期 通期業績予想



単位:百万円 ※百万円未満切り捨て (構成比)	2026年3月期	2027年3月期	
	実績	予想	前期比
HMI事業	34,085 (46.7%)	35,200 (46.6%)	+3.3%
インダストリアルコンポーネンツ事業	13,005 (17.8%)	13,000 (17.2%)	△0.0%
オートメーション&センシング事業	8,193 (11.2%)	8,800 (11.7%)	+7.4%
安全・防爆事業	12,665 (17.4%)	13,400 (17.7%)	+5.8%
システム	5,016 (6.9%)	5,100 (6.8%)	+1.7%
合計	72,967	75,500	+3.5%
国内売上高	24,500	25,400	+3.7%
海外売上高 (海外売上高比率)	48,466 (66.4%)	50,100 (66.4%)	+3.4% (一)

設備投資額・減価償却費・研究開発費



- 持続的な成長実現に向けた各種投資を推進

単位: 百万円 ※百万円未満切り捨て	2026年3月期	2027年3月期 (予想)	前期比
設備投資額	5,937	4,100	△30.9%
減価償却費	3,997	4,600	+15.1%
研究開発費	2,945	3,300	+12.1%

設備投資

- 各種システム(ERP、SCPなど)導入、ITセキュリティ強化、米国新拠点への設備投資は、2026年3月期までに概ね完了
- 2027年3月期は41億円の予想

減価償却

- 2026年3月期までの設備投資に関する減価償却費を、2027年度3月期より計上

為替レートと為替感応度



通貨	為替前提	1円変動による影響額 ※人民元は0.1円変動の影響額	
		売上高	営業利益
米ドル	150円	120百万円	10百万円
ユーロ	180円	90百万円	7百万円
人民元	21円	40百万円	5百万円

参考資料

新生IDEC

顧客中心のビジネス構造へ転換し
市場変化への対応力を向上

顧客中心のビジネス構造

- ・顧客ニーズに対応するグローバル体制
- ・顧客課題を解決するソリューション事業拡大

One IDECの実現

- ・事業と拠点のグローバル最適化
- ・デジタルを活用した顧客満足と効率化を両立するSCMの確立
- ・One IDECを支える体制整備

2028年3月期 目標

売上高 **770** 億円以上

営業利益率 **13** %以上

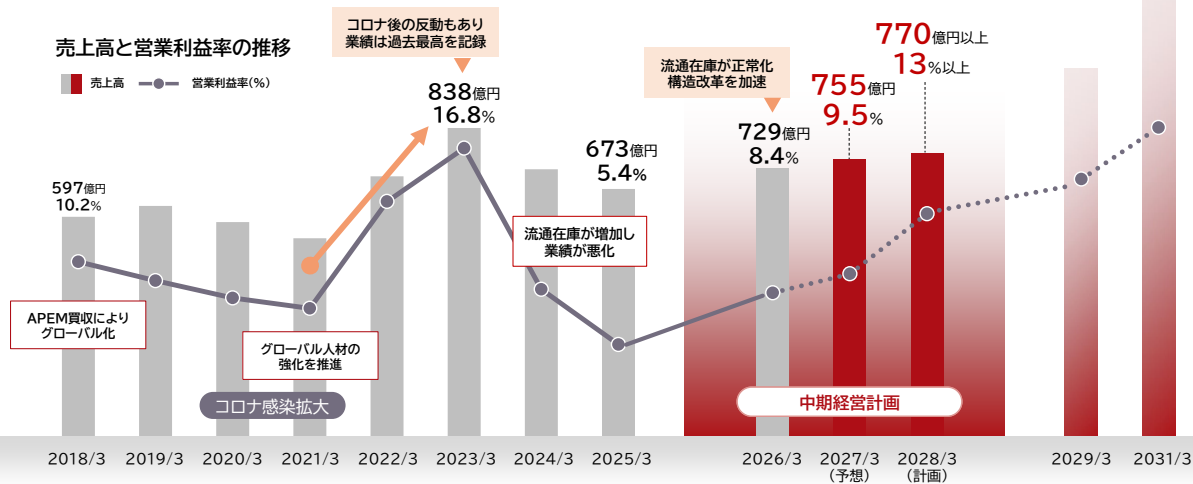
ROIC **7** %以上

中期経営計画



売上高と営業利益率の推移

■ 売上高 ● 営業利益率(%)

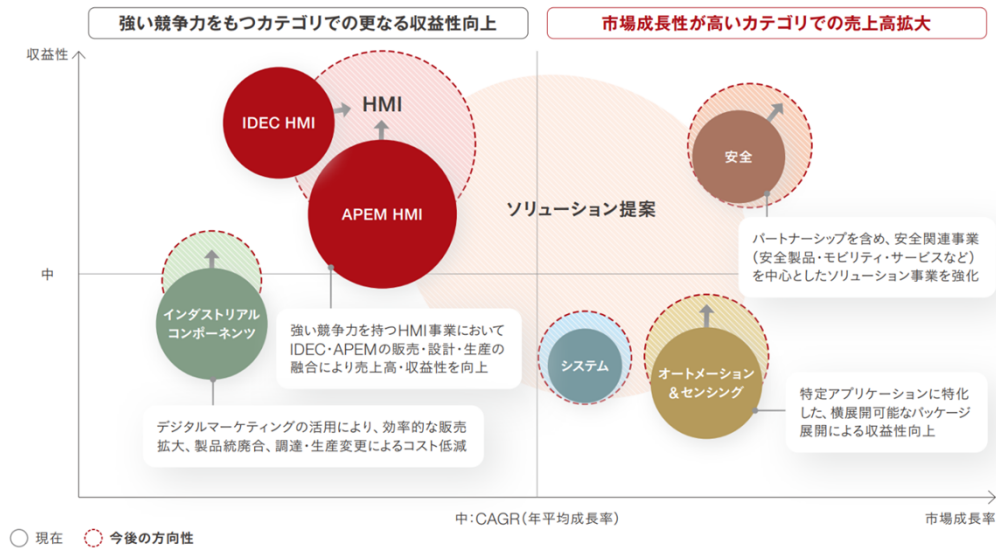


Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

事業戦略：事業のポートフォリオ



- 強い事業の収益性拡大と、市場成長の高いカテゴリでのソリューションを強化



Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

製品別売上区分



HMI

- 制御用操作スイッチ
- ジョイスティック
- 表示灯
- プログラマブル表示器
- セーフティコマンド

IDEC



APEM



インダストリアル コンポーネンツ

- 端子台
- 制御用リレー/ソケット
- スイッチング電源
- サーキットプロテクタ
- 産業用LED照明



オートメーション& センシング

- プログラマブルコントローラ
- センサ
- アシストホイールドライブ (AWD)
- セーフティホイールドライブ (SWD)
- 自動認識機器



安全・防爆

- 安全関連機器
 - ・非常停止用押ボタンスイッチ
 - ・イネーブルスイッチ
 - ・安全スイッチ
 - ・セーフティレーザスキャナ など



- 防爆関連機器



システム

- 制御盤
- 協働ロボットシステム
- セキュリティシステム
- その他各種システム



Copyright IDEC Corporation. All rights reserved.

この資料には一部当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。

従って、実際の業績などは、今後さまざまな要因によって計画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。

IDEC株式会社
経営戦略企画本部
TEL : 06-6398-2505
FAX : 06-6398-2587

